

出展料

区分		1小間/9m ² ()内は税込金額
一般		410,000円 (442,800円)
会員企業*1	通常	350,000円 (378,000円)
	早期	328,000円 (354,240円)
	早期大小間 (20小間以上)	307,500円 (332,100円)
その他出展費用		
角小間費用*2		15,000円 (16,200円)

申込方法

貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選び頂き、別添の展示会「出展申込書」裏面の「出展規約」をご確認頂き「出展申込書」に必要事項をご記入の上、運営事務局までご送付下さい。出展申込書を受理次第、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします。(原則会期前振込)

尚、2018年11月1日(木)から、公式HPでオンライン出展申込を開始いたします。書面同様に出展申込みでき、請求書をHPからダウンロードが可能になります。ぜひご利用下さい。

申込締切

早期申込締切日 ※会員企業は早期金額が適用	2018年11月30日(金)
最終申込締切日	2019年 1月31日(木)

取消料

出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り取消を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
2019年2月1日(金)まで	小間料金の 50%
2019年2月2日(土)以降	小間料金の100%

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にともない、会場利用が制限されます。

小間位置の決定

出展小間数、過去の出展履歴、会員/非会員などをもとに主催者が決定し、出展者説明会で発表します。

開催時間について

設営/撤去の時間を総合的に勘案し、以下の開催時間を予定しています。

6/5(水) 10:00~17:00
6/6(木) 10:00~17:00
6/7(金) 10:00~16:00

ブース造作について

効率的な設営/撤去を実現するために、パッケージブースのご利用にご協力をお願いします。詳細は別途ご案内いたします。

*1 対象: JPCA会員/JIEP正会員・賛助会員/JARA正会員・賛助法人会員/JEP・TEP正会員

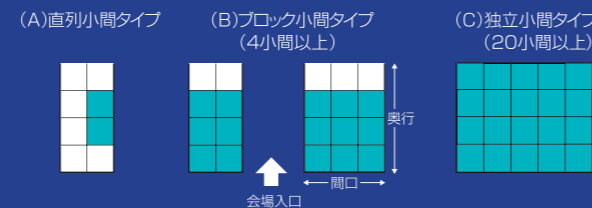
*2 小間位置決定の際、優先的に角小間に配置します。
※ 限りがございますので、お早めにお申込み下さい。

※ 角小間をお申込みの場合、角小間の開放面は、以下となります。

- ・直列: 2面開放(1箇所角小間)
- ・ブロック: 3面開放(2箇所角小間)

※ 角小間をお申込み頂いていない場合でも、角小間に配置された場合は角小間料金が適用されます。

小間形態



小間タイプ及び角小間のご希望に添いかねる場合もありますので、予めご了承下さい。

開催までのスケジュール(予定)

2018年
11/30(金) 早期出展申込メ切

2019年
1/31(木) 最終出展申込メ切
2/18(月) 出展者説明会(東京)
2/21(木) 出展者説明会(大阪)
4月上旬 招待状配布
4月下旬 各種提出書類期限
4月下旬 来場事前登録開始
6/3(月)~6/4(火) 搬入期間
6/5(水)~6/7(金) 展示会開催

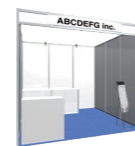
※最終日即日撤去

参考) パッケージブース

装飾と備品をセットにし、デザイン性も高いパッケージブースをご用意いたします。パッケージブースをお申込み頂くことで、手間も少なくご出展頂けます。様々なプランを随時公式HPで情報発信していきます。

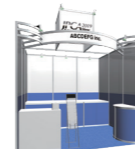
●1小間ベーシックプラン

75,000円(税別)
最低限必要なブース造作、電源、カーペットなどが付属したプランです。



●1小間/アップグレードプラン

264,000円(税別)
ブース造作、電源、カーペットの他、ブースの視認性を高めるサインや色使いを考えたプランです。



●2小間/アップグレードプラン

464,000円(税別)
ブース内に、棚やストックスペースを用途に応じて配置できるフレキシブルなプランです。



※上記の料金は装飾料金ですので、別途出展料が必要となります。

※仕様・価格は変動する場合があります。

※詳細は別途ご案内いたします。

本部事務局

一般社団法人 日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpcashow.com

運営事務局

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp



展示会公式サイトへ

JPCA Show

第49回 国際電子回路産業展

JIEP マイクロエレクトロニクスショー

第33回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC

第21回 実装プロセステクノロジー展

有機デバイス総合展

IoT 対応半導体・回路基板展

WIRE Japan Show

電気・光伝送技術展

Smart Sensing

スマートセンシング

JEP/TEP Show

JEP 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合



のせる つなぐ つくる そして ひろげる

6.5 ▶ 6.7

東京ビッグサイト 西1-4ホール+会議棟

電子機器2019
トータルソリューション展

www.jpccashow.com

出展の
ご案内

主催: 一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、 海外協力: 世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体
一般社団法人日本ロボット工業会
中国電子回路工業協会 (CPCA)、欧州電子回路協会 (EIPC)、インド電子工業会 (ELCINA)、
共催: 電子デバイス産業新聞[(株)産業タイムズ社]、電線新聞[(株)工業通信]、
香港線路板協会 (HKPCA)、米国電子回路協会 (IPC)、インド電子回路工業会 (IPCA)、
(株)JTBコミュニケーションデザイン、
全国電子部品流通連合会/東京都電機卸商業協同組合
韓国電子回路産業協会 (KPCA)、台湾回路板協会 (TPCA)
後援: 経済産業省

電子機器トータルソリューション展 2019

www.jpccashow.com

IoT、自動車、ロボット、医療、ウェアラブル等を具現化する技術の総合展示会

エレクトロニクス展示会の中でも専門性・注目度が高く、広く国内外からも多くの来場者を迎え、活発な交流や商談の場として、ご出展頂く皆様のビジネスを応援します。

本展示会ならではの出展効果向上プログラムをご覧頂き、出展をご検討下さい。

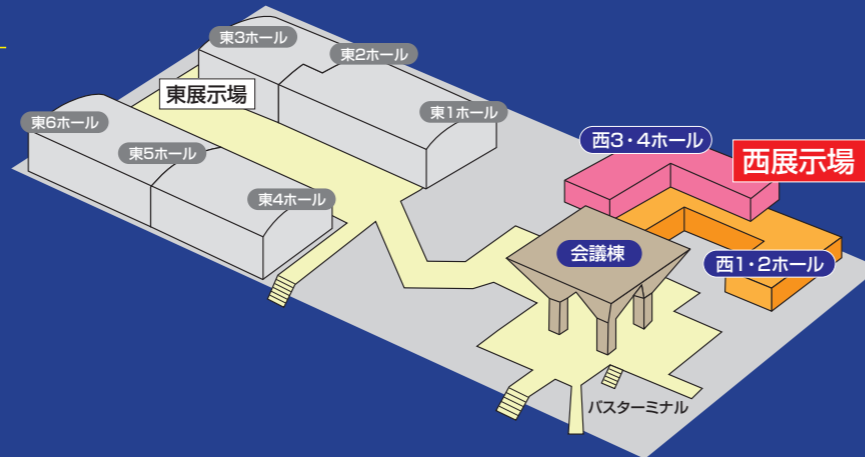
2019.6.5▶6.7 東京ビッグサイト 西1-4ホール+会議棟

2018年実績

出展規模 **516社 / 1,476小間**

来場者数 **50,827名**

セミナー聴講数 **12,571名**



展示会レイアウト案



有料 来場者情報の早期提供サービス

ブースへのご来場者様情報を、6月10日(会期終了直後の月曜日)にご提供いたします!!

迅速なご来場の御礼、情報のご提供等にご利用下さい。

●オンライン来場登録を推奨することで実現。

●データ納品のため、即アプローチが可能

※出展者説明会で詳細をご案内します。

無料 出展者プレゼンテーション

ご出展をより効果的にお使いいただくため、ご利用下さい。パネルやポスター等では伝えきれない情報のPRに!!

●セミナー会場(30分の講演)

●発表用機器完備

●セミナー受付スタッフ配置

※講演日時は、申込みの早い順に選択可能です。

主な来場企業

- 自動車関連: アイシン精機、朝日電装、市光工業、カルソニックカンセイ、ケーヒン、KOA、小糸製作所、スタンレー電気、住友電装、ダイハツ工業、デンソー、東海理化、東洋電装、トヨタ自動車、日産自動車、日本発条、ハイオニア、日立オートモティブシステムズ、日野自動車、SUBARU、本田技研工業、マツダ、三菱自動車工業、矢崎部品
- OA・ロボティクス: オムロン、キーエンス、キヤノン、コニカミノルタ、サイバーダイン、山洋電気、JUKI、セイコーエプソン、パナソニック、パナソニックスマートファクトリーソリューションズ、ファナック、FUJII、富士ゼロックス、三菱電機、安川電機、ヤマハ発動機、リコーインダストリー、リコージャパン
- 情報・通信関連: アップル、インテル、NHKメディアテクノロジー、NTT、NTTドコモ、沖電気工業、韓国放送公社(KBS)、京セラ、KDDI、ソフトバンク、東京放送ホールディングス(TBS)、東芝情報システム、日本IBM、日本電気、日本マイクロソフト、日本ユニシス、パナソニック、PFU、日立製作所、Huawei、フジクラ、富士通、村田製作所
- AV・家電関連: LGエレクトロニクス、カシオ計算機、キヤノン、Samsung Electronics、シャープ、ソニー、ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、ダイキン工業、ニコン、パイオニア、パナソニック、富士通ゼネラル、ヤマハ、ローランド
- 医療機器関連: オリンパス、Siemens、島津製作所、白河オリンパス、テルモ、東芝メディカルシステムズ、日立ハイテクノロジーズ、日立ヘルスケア・マニュファクチャリング、富士フイルム、マーク電子、モリタ東京製作所
- 半導体デバイス関連: インテル、STマイクロエレクトロニクス、キヤノン、サムスン電子、SCREENホールディングス、ソニー、TDK、東京エレクトロン、東芝メモリ、ニコン、日立ハイテクノロジーズ、富士通セミコンダクター、マイクロンジャパン、ルネサスエレクトロニクス、ローム
- 航空・宇宙関連: IHI、NECスペーステクノロジー、JAXA(宇宙航空研究開発機構)、シンフォニアテクノロジー、ナブテスコ、日本アビオニクス、日本電気、三菱重工業、三菱電機
- その他: 海上自衛隊、陸上自衛隊、東京ガス、東京電力ホールディングス、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、東日本旅客鉄道
- 電子回路基板: アドバンテスト、イースタン、イビデン、エルナー、協栄産業、京写、京セラ、キョウデン、シライ電子工業、伸光製作所、新光電気工業、住友電工プリントサーキット、大昌電子、日東電工、日本シイエムケイ、日本メクトロン、パナソニック、日立化成、フジクラ、富士通インターコネクテクトテクノロジーズ、メイコー、山下マテリアル、利昌工業

構成展示会・出展対象

電子回路技術	高密度実装技術	電子部品実装技術	新規回路形成技術	電気・光伝送技術	センサー技術	半導体・電子部品
<p>JPCA 2019 Show 第49回国際電子回路産業展</p> <p>●プリント配線板技術展 製品(電子回路基板等の電子機器)、設計技術、信頼性/検査技術、主材料/絶縁材料、機能材料/プロセス材料/資機材、製造装置/設備、環境システム、物流システム</p> <p>●半導体パッケージング・部品内蔵技術展 モジュール基盤、モジュール実装/設計、モジュール基盤/実装材料、製造プロセス技術/資機材、物流/環境対応システム</p> <p>●フレキシブルプリント配線板製品出展エリア</p> <p>●機器・半導体受託生産システム展 プリント配線板実装基板、モジュール実装基板、各種集積回路/実装/組立/検査受託サービス</p>	<p>JIEP マイクロエレクトロニクスショー</p> <p>第33回 最先端実装技術・パッケージング展</p> <p>高密度実装技術全般 展示会内パビリオン: アカデミックプラザ/eX-tech</p>	<p>JISSO PROTEC</p> <p>第21回 実装プロセステクノロジー展</p> <p>電子部品実装機及び関連機器/システム、半導体実装機/システム、検査/試験装置、実装設計システム</p>	<p>有機デバイス総合展</p> <p>IoT対応半導体・回路基板展</p> <p>各プリントドエレクトロニクス、部品/MEMS/センサー、LED/OLED/有機半導体に関する応用製品、材料、装置/システム、設計/分析システム、検査/評価測定技術 等</p>	<p>WIRE Japan Show</p> <p>電気・光伝送技術展</p> <p>産業用機器、電線/ケーブルおよびコネクタ、電線加工機、配線用部材、ワイヤーハーネス、電線/ケーブル用計測器、(電線/ケーブル/ハーネス)製造装置、検査機、M2M、光伝送</p>	<p>Smart Sensing</p> <p>スマートセンシング</p> <p>センサー/センサーノード関連、半導体/部品デバイス、電子機器、通信デバイス/ネットワークシステム、ソフトウェア関連、データプラットフォーム、電源、その他周辺機器/技術/サービス</p>	<p>JEP/TEP Show</p> <p>JEP 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合</p> <p>半導体、電子デバイス、センサー、機構部品、FA制御機器、計測器、電源、IoT/M2Mソリューションのご提案</p>